

# SSI-M + NH-MDL

Die Newcomer mit großer Zukunft  
*Newcomer with a big future*



Wer eine große Zukunft haben will, muss besser sein als andere. So ist es auch bei den **Lotpasten SSI-M** und **NH-MDL**. Sie wurden speziell für kontaktloses Löten entwickelt und überzeugen mit besten Eigenschaften. Sie sind vielseitig einsetzbar und lassen sich problemlos an Arbeitsabläufe anpassen.

*If you want to have a big future you have to be better than the others. And so it is with the **solder pastes SSI-M and NH-MDL**. They were specially developed for contactless soldering and are convincing with their excellent characteristics. They can be used for a wide variety of applications and can be adjusted for work processes without any problems.*

- ▶ **stabile Dosiereigenschaften**
- ▶ **einfache Kontrolle der Lotpastenmenge**
- ▶ **zuverlässige Lötstellenverbindungen**
- ▶ **RoHS-konform**

- ▶ **stable dosing characteristics**
- ▶ **simple control of the quantity of solder paste**
- ▶ **reliable solder joint connections**
- ▶ **RoHS compliant**

Speziell für kontaktloses Löten,  
wie z.B. Laser, Licht- oder Induktionssysteme

*Especially for contactless soldering,  
e.g. laser, light systems or induction systems*

## SSI-M halogenaktivierte Lotpaste / halogen-activated soldering paste

### Spezifikation / specification

ROL1 Flussmittelklassifizierung / flux classification

Legierung <i>alloy</i>	Zusammensetzung <i>composition</i>	Korngröße <i>grain size</i>	Flussmittelanteil (%) <i>flux content</i>	Viskosität <i>viscosity</i>
LFM-48	Sn-3.0Ag-0.5Cu	W: 20-38 µm U: 10-28 µm	13.0 wt	80 Pa·s

## NH-MDL halogenfreie Lotpaste / halogen-free soldering paste

### Spezifikation / specification

ROL0 Flussmittelklassifizierung / flux classification

Legierung <i>alloy</i>	Zusammensetzung <i>composition</i>	Korngröße <i>grain size</i>	Flussmittelanteil (%) <i>flux content</i>	Viskosität <i>viscosity</i>
LFM-48	Sn-3.0Ag-0.5Cu	U: 10-28 µm	13.0 wt	90 Pa·s
LFM-89	Sn-57.6Bi-0.4Ag	W: 20-38 µm	12.0 wt	80 Pa·s

Für mehr Informationen sprechen Sie bitte mit Ihrem Almit-Fachberater. / For further information please speak to your specialist Almit adviser.

## Über den Einsatz von kontaktlosem Löten / About the use of contactless soldering

Gehört dem kontaktlosen Löten die Zukunft? Eingesetzt wird kontaktloses Löten heute vor allem dort, wo feinste Lötstellen eine stabile Verbindung garantieren müssen. Das ist in der Automobilproduktion der Fall genauso wie in der digitalen Welt. Möchten Sie mehr erfahren über Hochleistungsprodukte für kontaktloses Löten? Sprechen Sie mit uns, wir haben für jede Anwendung die richtige Lösung.

*Does contactless soldering have a place in the future? Contactless soldering is used where the smallest solder joints must guarantee a stable connection. This is the case in automobile manufacturing just as it is in the digital world. Would you like to learn more about high-performance products for contactless soldering? Speak to us, we have the right solution for every application.*

### Die Vorteile von kontaktlosem Löten auf einen Blick

### The advantages of contactless soldering at a glance

- ▶ keine Überhitzung von Bauteilen
- ▶ kürzere Taktzeiten
- ▶ für sehr feine Lötstellen
- ▶ auch für kleinere Stückzahlen

- ▶ no over-heating of structural elements
- ▶ reduced repeat interval times
- ▶ for very small solder joints
- ▶ also for smaller production numbers

## SSI-M und / and NH-MDL im Test-Vergleich / in comparative test

Getestet wurden die Produkte von Almit im Vergleich mit einer herkömmlichen Lotpaste. Der Test beweist: Die besseren Benetzungseigenschaften haben SSI-M und NH-MDL.

*The Almit products were tested in comparison with a conventional solder paste. The test proves: SSI-M and NH-MDL have the better wetting characteristics.*

### Dioden Laser

Testmethode / test method

0 – 30 W, 1,5 Sek./seconds

Leistung / power

Ø 1.00 mm durchkontaktiert / through-plated

Stecker / plug



### SSI-M (LFM-48 U)

### Wettbewerber / competitor



vor dem Löten / before soldering

### NH-MDL (LFM-48 U)

### Wettbewerber / competitor



vor dem Löten / before soldering

### SSI-M (LFM-48 U)

### Wettbewerber / competitor



nach dem Löten / after soldering

### NH-MDL (LFM-48 U)

### Wettbewerber / competitor



nach dem Löten / after soldering

Für mehr Informationen sprechen Sie bitte mit Ihrem Almit-Fachberater. / For further information please speak to your specialist Almit adviser.